**深圳佰维存储科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录汇总表**

**（2023年12月29日）**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 🗹特定对象调研 🞎分析师会议🞎媒体采访 🞎业绩说明会🞎新闻发布会 🞎路演活动🞎专场机构交流会 🞎现场参观🞎其他  |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国投证券 王倜、国投证券 李奕臻、工银瑞信 高翀、工银瑞信 单文、工银瑞信 金兴、工银瑞信 修世宇、工银瑞信 曾剑宇、工银瑞信 刘展硕、鹏华基金 王璐、广发证券 栾玉民 |
| **会议时间** | 2023年12月29日 09：00-10：002023年12月29日 10：00-11：00 |
| **会议地点** | 佰维存储三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司管理层董办工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **Q1. 公司作为Meta 最新款AI智能眼镜的存储芯片供应商的优势是什么?**A1：Meta 最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta搭载高通第一代骁龙AR1平台，该平台专门针对散热限制在功耗方面进行独特设计优化，以打造轻量化的智能眼镜。公司研发封测一体化的布局，在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应、可靠性等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。 **Q2. 请介绍下公司发布的CXL 2.0 DRAM是一款怎样的产品?**A2：公司发布的CXL 2.0 DRAM采用EDSFF（E3.S）外形规格，内存容量高达96GB，同时支持PCIe 5.0×8接口，理论带宽高达32GB/s，可与支持CXL规范及E3.S接口的背板和服务器主板直连，扩展服务器内存容量和带宽。CXL是新一代的互联技术，在AI 和服务器领域有广泛的前景，公司将持续关注CXL技术。**Q3.** **公司四季度经营情况怎么样?**A3：公司9月单月营收已接近 5 亿元，Q4业绩进一步回升向好，毛利率迅速提升。从在手订单情况看，预计2024年Q1将会延续这样的态势，具体请关注公司后续披露的信息。**Q4. 公司是否具备晶圆级先进封测相关技术?该项目的技术团队背景是怎样的？**A4：公司已构建完整的、国际化的成建制专业晶圆级先进封装技术、运营团队。项目负责人拥有15年以上国际头部半导体公司运营管理经验，曾主持建立了国内首批12英寸晶圆级先进封装工厂并实现稳定量产。项目核心团队具备成熟研发和量产经验，熟练掌握晶圆级先进封装核心技术。晶圆级封测技术在先进存储器、逻辑芯片、HBM领域有广泛应用，公司会持续加强晶圆级封测技术的能力建设。**Q5. 公司是否有布局控制器IC设计？**A5：为了进一步深化产业链布局，公司已组建一批具备行业资深经验的芯片IC设计团队。目前，公司第一颗主控芯片研发进展顺利，已经回片点亮，正在进行量产准备。**Q6. 公司接下来的发展规划是怎样的？**A6：公司以“存储赋能万物智联”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。公司将持续深化“研发封测一体化2.0”布局，把握新一代信息技术的发展机遇，立足中国，面向全球，以优秀的经营业绩回报广大股东和投资者。 |
|  |  |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2023年12月29日 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |